

## Passivierungslösung für Kupfer bei der Herstellung von Leiterplatten



Die Passivierung von Kupfer verhindert die Korrosion von Leiterbahnen und gewährleistet die Lötbarkeit der Kupferoberflächen von Leiterplatten im weiteren Bearbeitungsprozess. Die Vermeidung der Oxidation spielt vor allem wegen der abnehmenden Querschnitte von Leiterbahnen eine immer wichtigere Rolle. Heute sind vor allem folgende Verfahren für die Leiterplattenoberflächen üblich : Heißluftverzinnung (HASL), organische Passivierung (OSP), chemisches Vernickeln, Tauchverzinnen, Tauchversilbern, chemische Palladiumbeschichtungen, Beschichten mit einer Kombination aus chemisch Nickel und Gold.

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

ermäßigter Preis 2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)